

## 未來計劃及[編纂]

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳盡說明，請參閱本文件「業務－我們的戰略」。

#### [編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），且[編纂]未獲行使，根據我們的戰略，我們擬將[編纂][編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元預計將用於加強我們的核心存儲類芯片及混合信號技術以及相關設計及處理平台的開發，旨在鞏固支撐我們未來產品組合的核心技術壁壘，以進一步推動我們產品矩陣的持續拓展。增強的研發能力對我們跟上技術轉型及不斷發展的行業標準的步伐至關重要，這使我們能夠維持在存儲類芯片市場的領先地位並滿足客戶不斷變化的技術要求。我們預計未來六年用於支持我們的研發擴張的資本開支需求約為人民幣2,000.0百萬元，其將通過經營現金流量及[編纂][編纂]的結合提供資金。具體而言：
  - [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於維持並進一步充實及壯大我們的研發團隊。我們預計在未來六年專注招聘及留住研發人才，尤其是產品設計師、測試工程師及技術支持人員，以支持我們新一代存儲類芯片產品、混合信號類芯片及相關配套產品的開發，這包括(i)基於更小存儲單元設計、更高性能和可靠性的存儲類芯片產品；(ii)混合信號類芯片產品領域的各類算法、新型傳感技術和先進封裝技術；及(iii)新型存儲類芯片解決方案，以更好地把握新興產業發展趨勢。我們預期聘用約100名新員工以擴大研發團隊的規模，包括(i)約30名產品設計師，專注於電路設計、產品開發及客戶特定解決方案；(ii)約50名測試工程師，負責產品驗證和質量保證；及(iii)約20名技術支持人員，提供面向客戶的技術援助和支持驗證階段活動。新僱員將包括在其各自領域擁有往績且經驗豐富的專業人士以及名校

## 未來計劃及[編纂]

畢業生。預期薪資將為每年度人民幣500,000元至人民幣2,000,000元不等，視乎職能及資歷而定。我們將通過具有競爭力的激勵措施及多元靈活的合作模式吸引及挽留研發人才，鞏固具有長期價值的人才基礎，並進一步增強競爭力；

- o [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於採購支持研發活動所需的各類關鍵資源，包括設備、軟件工具及工藝開發相關材料，以進一步支撐我們持續的技術迭代與研發活動。具體而言，我們計劃：(i)購置關鍵研發設備，包括晶圓及芯片級工藝故障分析系統及儀器（如回流焊設備）、環境及可靠性壓力測試設備（如高溫高濕／低溫低濕試驗箱以及高加速溫濕度應力測試(HAST)及無偏壓高加速應力測試(uHAST)設備）、電氣性能檢測設備（如大電流直流電源）、表面結構分析設備（如掃描聲學顯微鏡）等，以持續提升我們的實驗室測試能力，並支持我們的產品開發、可靠性測試及質量控制流程；(ii)採購及升級研發軟件工具，例如EDA（電子設計自動化）軟件及多次可編程IP，以及用於開發建設共享IP平台的工具，以確保與適用於我們新產品的工藝技術兼容並促進我們的芯片設計；及(iii)採購我們的工藝工程及開發工作所需的輔助材料及服務；
- o [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於擴張我們的研發設施，新增實驗室、機房及研發人員辦公空間，以更好地容納我們日益擴張的研發團隊，滿足研發和實驗訴求，並為引入更多先進研發設備提供必要的空間和條件。具體而言，我們計劃收購一項位於上海的物業，總建築面積約為4,734.37平方米，與我們現有總部位於同一工業園區內。該新物業將：(i)用作辦公室，以容納約250名研發人員；及(ii)設立國內領先的計算型高性能芯片測試實驗室，包括客戶產品展示區、可靠性測試區、芯片模擬與驗證平台，以及實際芯片原型的關鍵性能測試平台。該等新研發設施將具備高性能計算芯片的測試、驗證及客戶演示功能，從而對我們現有的研發中心作出補充；及
- o [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於促進我們與第三方團隊的合作，圍繞基於計算的各類高性能芯片及周邊配套產品開展聯合研發、技術驗證及解決方案優化工作，以加速我們的產品開發，提升公司在該等領域的技術能力，並進一步豐富公司的產品佈局。目標第三方開發商主要為具備成熟研發能力及互補技術資源的企業客戶。根據我們的行業經驗，全球有充足的該等合資格合作夥伴可供進行擬議合作。在擬議的合作模式下，各方將利用各自的技術優勢共同開發具備行業領先水平的新產品，且各方將保留其於合作過程中獨立

## 未來計劃及[編纂]

開發的知識產權的所有權，而任何共同開發的知識產權的所有權將按個別情況協商及釐定；

下表概述我們計劃用於提升研發能力的[編纂][編纂]的按階段分配計劃。我們認為該等開支將加強我們的長期競爭力及支持未來收入增長。有關我們正在進行的研發計劃的進一步詳情，請參閱「業務－研發」。**[編纂]**務請注意，該等計劃乃基於假設，並受不確定因素影響，包括本文件「風險因素」一節所述的風險。因此，我們無法保證我們的計劃將如期進行或我們的目標將完全實現。

|                    | 2026年  | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | (百萬港元) |       |       |       |       |       |
| 研發團隊的維護和擴張 . . . . | 38.4   | 76.8  | 122.8 | 162.9 | 200.8 | 235.1 |
| 研發資源採購 . . . . .   | 14.4   | 39.0  | 39.0  | 39.0  | 39.0  | 39.0  |
| 研發設施 . . . . .     | —      | 156.9 | —     | —     | —     | —     |
| 第三方研發合作 . . . . .  | 27.3   | 59.6  | 94.4  | 136.6 | 94.4  | 84.5  |
| 總計 . . . . .       | 80.1   | 332.2 | 256.2 | 338.4 | 334.1 | 358.5 |

- [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於完善我們的供應鏈佈局、強化中國境外團隊建設及海外營銷推廣活動，具體而言：
  - [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於完善我們的供應鏈，持續提升我們的物流及倉儲全球佈局，有效降低供應鏈風險，並提升我們的供應穩定性、響應速度與交付質量。我們預期一個穩健及多元化的供應鏈將促進我們的海外市場擴張、優化供應鏈成本及支持海外市場的收入增長。我們的供應鏈擴張將戰略性地專注於新加坡及韓國。這些是我們擁有業務的現有市場，該等市場擁有成熟的半導體生態系統，具備國際認可的晶圓代工廠及OSAT服務供應商、支持性的產業政策，且下游客戶對與我們產品組合相若的產品有既定需求。具體而言，我們計劃：(i)進一步深化我們與海外知名晶圓廠及封測廠的合作，逐步建立與完善這些重點區域的採購與供應鏈質量管理功能；(ii)招聘供應鏈人員並組建本地相關團隊；及(iii)租賃或建設海外物流設施及倉儲點。我們目前的供應鏈主要位於中國。計劃的擴張將加強我們的本地團隊和設施，以加強生產協調及更好地服務於海外客戶。我們預期將[編纂][編纂]淨額中的約人民幣165.3百萬元投資於提升供應鏈的資本開支，並於未來6年平均分配；
  - [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於加強我們的海外團隊建設。具體而言，我們計劃(i)吸引駐於歐洲的海外優秀的高端產

## 未來計劃及[編纂]

品設計團隊與增加約10名具有10年以上相關經驗的人才，其預期平均薪資將介於1,500,000港元至6,000,000港元的範圍之間；及(ii)與全球頂尖研發團隊建立聯合研發合作，以支持我們持續的技術升級及全球業務的擴展。截至最後實際可行日期，我們正積極尋求與擁有良好往績記錄的國際頂尖研發團隊進行合適的海外共同開發機會。擬定合作將利用各方各自的技術優勢，共同開發符合行業趨勢或為當地市場需求量身定制的芯片。截至最後實際可行日期，我們尚未就該等共同開發訂立任何具約束力的合作框架或最終合作夥伴安排；及

- o [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於海外市場推廣與營銷活動費用，包括開展海外品牌營銷宣傳、參與具有全球影響力的行業展會等，以加深我們與全球客戶的關係，進一步提升我們在海外市場的知名度和影響力。我們已選擇歐洲作為全球營銷及品牌推廣活動的重心，此乃考慮到其多元化的汽車及工業產品客戶基礎，加上當地的競爭格局為新進入者提供了建立長期業務的實質空間。選擇歐洲亦與我們海外產品設計團隊的擬定地點一致，我們預期這使我們的設計團隊能夠緊貼當地客戶需求及市場趨勢，同時，我們的營銷及品牌推廣活動亦能相應產生客戶洞察及商業機遇以回饋至產品設計中，從而形成相互促進的循環，支持我們的海外擴張策略；
- [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於戰略投資及／或收購，重點關注與我們現有產品組合產生協同效應的投資及收購機會，以提升我們的設計能力、工藝技術及供應鏈能力，並支持橫向擴展至新興領域。我們將會在全球範圍內尋求潛在的戰略投資與收購機會，重點關注全球範圍內具有行業先進性的、高壁壘的，並與我們現有業務或銷售渠道產生協同效應且符合產業發展趨勢的芯片設計企業。具體而言，理想的目標應為我們供應鏈內具備以下條件的公司或初創公司：(i)具有符合我們戰略方向的先進技術及研發成果，並擁有至少一項獨立開發的核心知識產權；(ii)有由至少五名敬業成員組成的穩定的核心研發及管理團隊，具備深厚的行業知識及在特定領域的相關經驗；(iii)至少一項商業上可行的研發成果，一個穩定或創新的業務模式及良好的市場聲譽；及(iv)最近一個財政年度用於研發的支出不低於人民幣2百萬元。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2025年，全球有超過300家半導體行業公司符合我們的標準，為我們提供了大量的可行目標儲備。我們將以審慎、開放的態度甄別與公司戰略方向相匹配的優質標的，在充分評估的基礎之上穩健推進戰略投資與資源整合，以實現技術能力的快速增強及產品線的加速拓展。截至最後實際可行日期，我們並無確定任何具體潛在收購目標。預期獲分配[編纂]淨額將在未來6年內於合資格投資機會出現時使用。該等投資預期將增強我們的研發能力、優化供應鏈效率及擴大我們的市場份額；及
- [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元，預計將用於營運資金及一般企業用途。

---

## 未 來 計 劃 及 [ 編 纂 ]

---

倘[編纂]定為指示性[編纂]的[編纂]或[編纂]，則[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。倘我們上調或下調[編纂]以將最終[編纂]設定為高於或低於[編纂]的中位數，我們將按比例增加或減少用於上述用途的[編纂]的分配。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]淨額將為(i)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]）、(ii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]的中位數）及(iii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]）。

倘[編纂][編纂]淨額（包括行使[編纂][編纂]淨額）多於或少於預期，我們可按比例調整就上述用途分配[編纂]淨額。

我們僅會將並非即時需要作上述用途的[編纂][編纂]淨額存放於證券及期貨條例或其他司法管轄區適用法律及法規所界定的持牌商業銀行及／或認可財務機構的短期計息賬戶。我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。